

Kratzer Automation

MES: Material- und Prozessmanagement

Kratzer Automation präsentiert die jüngste Version des Manufacturing-Execution-Systems (MES) intraFactory. Die für die Elektronikfertigung optimierte Software-Suite unterstützt das Material- und Prozessmanagement über alle Stufen des Produktionsprozesses. Dabei sorgt die Integration von Materialmanagement, Feinplanung, Betriebs- sowie Maschinendatenerfassung (BDE/MDE) für mehr Wirtschaftlichkeit: Mit intraFactory lassen sich Materialströme genauer steuern und optimieren, was insbesondere bei Fertigungsunternehmen mit hohen Materialkostenanteilen zu Effizienzsteigerungen führt. Durch exakte Kenntnis des Materialverbrauchs ist die Planung von Materialverfügbarkeiten präziser möglich, als mit ERP-Systemen. Der Abgleich der Soll- und Ist-Daten über die Online-Integration der Betriebsdatenerfassung erlaubt den sofortigen Eingriff, wenn Abweichungen im Produktionsablauf entdeckt werden. Mit der erweiterten Wareneingangslösung lassen sich Herstellerinformationen über Chargennummer, Gebinde, Verfallsdatum usw. in einem Scanvorgang einlesen. Die manuelle Erfassung von Herstellerangaben beim Wareneingang wird damit erleichtert. (su)

Halle 7, Stand 309, www.kratzer-automation.com

Contag

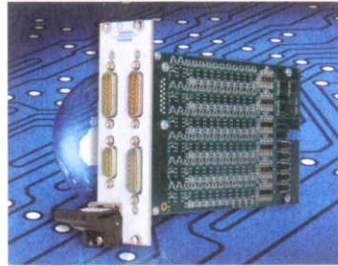
PCB-Technologien

Sein erweitertes Produktportfolio präsentiert PCB-Hersteller Contag. Das Highlight auf der Messe werden die Impedanz-definierten Schaltungen sein, die Contag neu im Programm hat. Auch über die Investitionen in neue Technologien und die Anschaffung neuer Maschinen und Anlagen wird auf der SMT berichtet. (su)

Halle 9, Stand 429, www.contag.de

Pickering Interfaces

Innovative LXI- und PXI-Lösungen



Pickering Interfaces erweiterte die Palette an LXI-konformen Schaltprodukten mit der Einführung der Hochspannungsmatrix 60-310 und der Matrix 60-510 mit geringer Thermospannung. Das LXI-Schaltssystem 60-310, untergebracht in einem 19-Zoll-2 HE-Gehäuse, ist eine zweipolige 300 x 2-Hochspannungsmatrix, die Signale bis 500 VDC unter Spannung oder bis 1000 VDC (700 VAC) leistungslos schalten kann. Für die Durchführung von Isolationsprüfungen an Kabelbäumen oder Leiterplatten oder für Überspannungstests an Halbleitern oder Relais ist diese Matrix geeignet. Das LXI-Schaltssystem 60-510 ist eine 56 x 33-Matrix mit niedriger Thermospannung. Mit ihr können Signale von bis zu 150 VDC bzw. bis 1 A (max. 10 W) geschaltet werden. Durch den Einsatz von Relais mit Ruthenium-Kontakten werden eine hohe Lebenserwartung und sehr gute Kleinsignaleigenschaften erreicht. (su)

Halle 7, Stand 634, www.pickeringtest.com

Andus Electronic

Subminiatur-Leiterplatte

Andus informiert über seine Leiterplatten-Highlights des letzten Jahres: Dickkupfer bis 3 mm Stärke, HDI-Multilayer mit 50 µm Strukturen im LDI-Verfahren, HF-Boards bis 100 GHz und vieles mehr. Zudem stellt Andus eine Subminiatur-Leiterplatte vor: Mit nur 0,8 mm Durchmesser ist dieser Bilayer für 2 Bauelemente kleiner als der Durchmesser einer Pin-Nadel. (su)

Halle 8, Stand 209, www.andus.de

Häusermann

Alternative zur Starrflex-Leiterplatte



Sollen die Leiterplatten beim Einbau und Service lediglich leicht gebogen werden, dann ist der Einsatz von teuren flexiblen Materialien und die damit verbundenen aufwändigen Fertigungstechniken meist nicht wirtschaftlich. Häusermann hat eine Alternative zu herkömmlichen Starrflex-Lösungen entwickelt: HSMtec. Durch das Verlegen von Runddrähten und Profilen unter der ersten Lage (Außenlage) wird eine elektrische Verbindung zwischen zwei oder mehreren Schaltungseinheiten hergestellt. Die Drähte und Profile lassen sich stoffschlüssig in die Signalführung einer Baugruppe integrieren. Nach Fertigstellung der Multilayer-Leiterplatte lassen sich mittels Tiefenfräsungen die Sollbiegestellen für die Biegung setzen. Durch die eingesetzte Kerbfräsung ist der Abstand zwischen den starren Teilen auf das absolute Minimum reduzierbar. (su)

Halle 9, Stand 409, www.haeusermann.co.at

Zevac

Rework-Plattform

ONYX 29 nennt Zevac seine »Advanced Rework Plattform«. Der leistungsfähige, große 6000W-Vier-Zonen-Vorwärmer nimmt Leiterplatten mit einer Größe von bis zu 500 mm x 500 mm auf. Das MFOV-Visionssystem erlaubt die komplette Visualisierung von Bauelementen bis zu 75 mm x 75 mm ohne Optikwechsel. Zum Schutz sensibler Bauelemente wird u. a. die Kraftmessung beim Platzieren, Dispensen, der Restlotabsaugung und der Bauelement-Aufnahme eingesetzt. Mit dem ONYX 29 lassen sich alle

SMD-Bauelemente wie Chips bis zu 0201, Flip-Chip, µBGA, CSP, BGA, LGA, MLF, CCGA, TCP, QFP und Fine-Pitch, Stecker und Sockel, RF-Abschirmungen und kundenspezifische Bauelemente einfach und sicher verarbeiten. Geeignet ist die Plattform für Reparaturen, Prototypen, Nachbestückung und kleine bis mittlere Serien. (su)

Halle 9, Stand 250, www.zevac.de

Essemtec

Prüfen und Bestücken



Eine Sicherheitslücke beim Bestücken schließt Essemtec: Das Messsystem FLX-CVU ist eine Option zu den hochflexiblen Bestückungsautomaten FLX2011. Die FLX-CVU prüft die elektrischen Bauteileigenschaften direkt auf der Bestückungsmaschine und ermöglicht so eine hohe Bestückungssicherheit und Produktqualität. Durch die direkte Messung am Bauteil lassen sich Rüstfehler, Beschriftungsfehler und Verpackungsfehler ausschließen. Die Kontrolle kann auch Abweichungen innerhalb einer Bauteilrolle feststellen und die Bestückung fehlerhafter oder außerhalb der Toleranz liegender Bauteile verhindern. Alle Messwerte stehen in einer Datenbank zur Verfügung und ermöglichen die Rückverfolgung bis auf das einzelne Bauteil. Die Messkontakte sind so geformt, dass verschiedene Bauformen und Bauteilgrößen geprüft werden können. Kompliziertes Justieren, Umrüsten und Kalibrieren von Prüfkontakten oder Greifern ist deshalb nicht notwendig. Die Messstation ist verbunden mit einem universellen Messgerät, das den Widerstand, die Kapazität, die Induktivität und die Polarität äußerst genau und schnell bestimmen kann. (su)

Halle 7, Stand 203, www.essemtec.com